

未来 COLLEGE

半導体業界のミライを探る インターンシップ合同説明会 2023

ポスドク歓迎
学年不問!!

対面
東京

6.10 (土)
11:00-17:00

東京文具共和会館
(浅草橋駅徒歩3分)



6.18 (日)
11:00-17:00

高槻城公園芸術文化劇場 北館
(高槻市駅徒歩4分)

大阪会場限定 ポスドク・博士課程の方に限り
ブース面談枠の事前予約を実施!(先着順)



対面
大阪

オン
ライン

6.3 (土) | 14 (水), 15 (木)
10:00-18:00 | 16:00-20:00
(Microsoft Teamsで開催)



◆出展企業

(全32社、対面21社、オンライン26社)

企業特典
(予定)



…エンジニアと会える・話せる



…特典映像あり



…実機(製品)を見られる

アドテックプラズマテクノロジー、アプライド マテリアルズ ジャパン、旭ダイヤモンド工業、イオンテクノセ
ンター、荏原製作所、大阪真空機器製作所、KOKUSAI ELECTRIC、コベルコ科研、JSR、ジェイテッ
クコーポレーション、芝浦メカトロニクス、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing、
ジャパンマテリアル、SCREEN ホールディングス、住友ベークライト、ソニーセミコンダクタソ
リューションズ、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、ダイフク、THK、東京エレクトロン、
東京精密、東芝デバイス&ストレージ、TOWA、日新イオン機器、日本テキサス・インスツルメンツ、
日本マイクロニクス、日立ハイテク、フジキン、堀場製作所、マイクロンメモリジャパン、村田機械、
ローテック

インターンシップ合同説明会
参加申込はコチラ

主催



SEMI は半導体製造関連業界唯一の
グローバル団体です。

インターンシップ合同説明会の詳細、業界MAP、
製造プロセス、座談会動画など役立つコンテンツが
盛りだくさん!

未来 COLLEGE

